

# 高迪 853 恒温无铅预热台 BGA返修台 数码显

产品名称	高迪 853 恒温无铅预热台 BGA返修台 数码显
公司名称	东莞市南城集达电子工具经营部
价格	340.00/个
规格参数	品牌:高迪 型号:853 最大电压:230v (v)
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞东城赛格电子市场
联系电话	86-076922322692 13728222414

## 产品详情

防静电.宽温度范围设计拆焊系统,高精度智能控温电路,简单的操作方式,本系统预热采用大功率120mm\*120mm远红外发热体,加温迅速,特性极佳.独到的隔热设计,机壳温升较低,使得系统的温度范围可大幅提高等优越性能!可拆可焊,更适合处理大面积bga和电脑主板扩展槽的拆卸与安装!

额定电压	ac 230v 50hz
最大功率	605瓦(w)
发热类型	远红外发热盘
温度范围	100 -500
外形尺寸	221*251*112 ( mm)

用途:适用于电子 电器 通讯 维修等pcb板工业板的预热\加温\辅助元件拆焊

很多新手认为预热台好比是电丝炉或者是锡炉，是用来拆元件的，这是极大的认识错误。预热台的用途不是用来拆元件的，而是bga焊接辅助加热来提高成功录和提高焊接质量。能加快bga焊接的时间，而减少损坏bga芯片，它是bga焊接必不可少的辅助工具。

底部预热的目的：除pcb上的潮气，避免bga返修时出现的异常性气泡。避免由于pcb板单面受热而产生的上下过高温差，致pcb或bga焊盘之间的硬力而翘起和变形。底部加热可以升高pcb的温度。而顶部风枪的加热则用来加热bga芯片，芯片加热时，部分热量会从返修工位传导流走。而底部加热则可以补偿这部分的热量，通过底部预热，对bga锡球和pcb焊盘的可靠焊接做必要和辅助的热量，从而缩短bga上方的回流焊区时间。避免bga长时间在高

温区内。提高返修理工可靠性。经过测试建议大尺寸的bga芯片实际温度控制在150-160度之间。而比较小的bga芯片则建议温度控制在120-150度之间。

"高迪 853 恒温无铅预热台 BGA返修台 数码显"的品牌为高迪，型号是853，最大电压为230V（V），功率是605W（W），额定温度为100 -500（ ），主要用途是预热电板